证券代码：002745　　证券简称：木林森　　公告编号：2026-034

木林森股份有限公司

关于拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司签订投资合同书暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。本次投资事项无需股东大会审议。

2. 本次项目实施主体为公司现有经营主体，项目推进不涉及新设公司、并购相关安排。本次投资项目尚需按照法律法规的规定办理项目备案、节能审查、工程建设报建、消防审验、质量安全监督、施工许可和环保等手续，存在不确定性；

3.合同中的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，项目实际投资金额、建设周期等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额和建设周期具有不确定性；

4.本次项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险；

5.本合同的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次对外投资概述

木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟与江西省吉安市井冈

山经济技术开发区招商管理有限公司签订投资合同书暨对外投资的议案》，同意公司与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司（以下简称“井开区招商公司”）签订《半导体封装研发制造项目投资合同书》，拟在井冈山经济技术开发区投资建设半导体芯片封测项目及半导体封装项目，预计 2028 年底总投资额 22.5 亿元，购置固晶、焊线、塑封、测试等核心设备开展研发制造，产品包括但不限于照明电源管理芯片封测、照明控制驱动芯片封测及 Mini/Micro LED 封测产品，本项目投资资金来源为公司自有资金加自筹资金。同时提请董事会授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议、技术手段选择、办理项目开工、施工及竣工手续等）。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议对方基本情况

1．名称：江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司

2．统一社会信用代码：91360805MADT1R6G57

3．成立日期：2024 年 7 月 24 日

4．法定代表人：肖惠兴

5．注册资本：5,000 万元

6．企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7．地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号

8．性质：国有控股企业

9．关系说明：井开区招商公司与公司不存在关联关系。

三、投资协议的主要内容

（一）投资协议的主要内容如下：

甲方:江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：木林森股份有限公司（以下简称“乙方”）

第一条　项目概况

第 1.1 条　项目基本情况：项目为半导体芯片封测项目及半导体封装项目：预计 2028 年底总投资额 22.5 亿元，购置固晶、焊线、塑封、测试等核心设备开展研发制造，产品包括但不限于照明电源管理芯片封测、照明控制驱动芯片封测及 Mini/Micro LED 封测产品，持续壮大半导体与光电显示产业集群。

第二条　项目选址

根据井冈山经济技术开发区（以下简称“经开区”）总体规划，确定项目选址在经开区企业现有空置厂房及闲置地块（井冈山经济技术开发区创业大道木林森产业园）。具体地块编号、四至范围及宗地面积以本合同项目用地的《国有土地使用权出让合同》为准。

第三条　项目要求

第 3.1 条　项目注册：本项目以乙方木林森股份有限公司在吉安的关联公司为项目主体，本次项目实施主体为公司现有经营主体，项目推进不涉及新设公司、并购相关安排。

第 3.2 条　项目建设进度：乙方应自本合同签订之日起，75 日内进场开工，12 个月内完成设备安装调试并正式投产。

第四条　项目商务条款

为支持乙方项目发展，甲方在法律、法规及政策文件的规定范围之内，为乙方项目提供商务支持。

第五条　甲方权利义务

第 5.1 条　甲方依法依规督促乙方严格履行本合同约定的项目建设内容、经济指标等要求。

第 5.2 条　甲方应为乙方提供良好的投资环境，积极为乙方项目相关审批流程提供服务，促进乙方投资项目早日建成投产。

第 5.3 条　法律、法规规定的其他权利和义务。

第 5.4 条　甲方有权对项目进展进行现场核查。

第六条　乙方权利义务

第 6.1 条　乙方应在项目投产后 2028 年底累计完成设备投入不低于 20 亿元，对最终设备投资金额认定存在争议的，以双方共同聘请的第三方机构核定为准。

第 6.2 条　乙方应严格按合同约定的建设内容进行项目建设，并按第 3.2 条约定完成项目建设进度，一次性完成项目建设并如期投产，所建厂房不对外出租（经甲方同意的除外）。

第 6.3 条　若乙方设立新公司作为项目实施主体，应确保项目正式投产后第二年内申报纳入规模以上工业企业。

第 6.4 条　乙方必须按照法律法规的规定办理项目备案、节能审查、工程建设报建、消防审验、质量安全监督、施工许可和环保等手续，接受并服从甲方城市建设、安全管理、环境保护等行政监管部门的监督与管理。项目必须严格执行环保设施、安全设施和消防设施建设“三同时”制度（同时设计、同时施工、同时投入使用）。

第 6.5 条　乙方应配合甲方及相关部门，提供统计项目投资、入规入统所需证照、建设装修和设备付款发票等相关资料。

第 6.6 条　法律、法规规定的其他权利和义务。

第 6.7 条　以上权利义务甲乙双方须严格履行，如未达到相关约定，经双方协商无果后，双方均有权解除合同，本合同未明确约定的损失，双方协商解决。

第七条　合同履行

第 7.1 条　本合同履行地为甲方住所地。

第 7.2 条　自本合同签约之日起，无论系甲乙双方任何一方原因，若 6 个月内乙方项目仍未取得政府相关部门对该项目的相关建设批文，或没有按照第 3.2 条项目建设进度约定时间进场施工等实质性进展，双方均有权解除合同。

第八条　争议解决

第 8.1 条　甲乙双方严格按本合同各条款规定履行，本合同具有法律约束力。

第 8.2 条　本合同的签订、生效、履行、变更和争议的裁决，以中华人民共和国法律为依据。本合同未尽事宜或遇不可抗力的情况时，甲乙双方本着友好协商的原则可另行协商变更或订立补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。

第 8.3 条　本合同在履行时如发生争议，甲乙双方本着友好协商的原则予以解决。未能协商解决的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。在争议处理过程中，除争议事项外，各方应继续履行本合同约定的其他条款。

第九条　生效条款

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲乙双方签字、盖章后生效。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1．公司本次与井开区招商公司签署合作协议，是双方深化合作、实现互利共赢的重要举措。本次投资符合公司整体经营发展规划，项目的落地实施将进一步深化公司在照明产业的战略布局，完善产业链纵深，与公司中长期发展战略高度契合，有助于持续巩固和提升公司核心竞争力，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2．本项目投资资金来源为自有资金加自筹资金，公司将在不影响现金流健康的前提下，分期安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。

五、风险提示

1. 本次项目实施主体为公司现有经营主体，项目推进不涉及新设公司、并购相关安排。本次投资项目尚需按照法律法规的规定办理项目备案、节能审查、工程建设报建、消防审验、质量安全监督、施工许可和环保等手续，存在不确定性；

2.合同中的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，项目实际投资金额、建设周期等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额和建设周期具有不确定性；

3.本次项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

4.本合同的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1．木林森股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

2.《半导体封装研发制造项目投资合同书》。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2026年11月21日